10/527468

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 26. September 2002 (26.09.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/074489 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: B24B 3 13/00, B24C 1/08

B24B 31/116,

.

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP02/03120

(22) Internationales Anmeldedatum:

20. März 2002 (20.03.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 13 599.8

20. März 2001 (20.03.2001) DI

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FISBA OPTIK AG [CH/CH]; Rorschacherstrasse 270, CH-9016 St. Gallen (CH). (72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FÄHNLE, Oliver [CH/CH]; Ruhbergstrasse 50, CH-9000 St. Gallen (CH).

(74) Anwalt: MÜNICH, Wilhelm; Kanzlei Dr. Münich & Kollegen, Wilhelm-Mayr-Str. 11, 80689 München (DE).

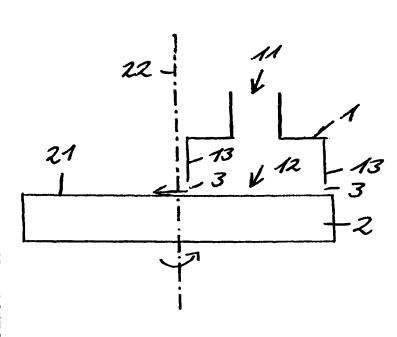
(81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR THE ABRASIVE MACHINING OF SURFACES OF ELEMENTS AND IN PARTICULAR OPTICAL ELEMENTS OR WORKPIECES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUR ABRASIVEN BEARBEITUNG VON FLÄCHEN VON ELEMENTEN UND INSBESONDERE VON OPTISCHEN ELEMENTEN BZW. WERKSTÜCKEN



(57) Abstract: The invention relates to a device for the abrasive machining of surfaces of elements. Said device comprises a tool (1) with an inlet (11) and an outlet (12), a supply unit that supplies a liquid to the inlet (11), said liquid containing dissolved abrasive agents and emerging from the outlet (12) and a positioning device, which guides the tool over the surface to be machined, positioning said tool in such a way that the outlet lies opposite the surface to be machined. According to the invention, the surface area of the annular gap (3) that is formed by the limiting walls (13) of the outlet (12) and the surface (2) to be machined is smaller than the cross-sectional surface of the inlet (11).

(57) Zusammenfassung: Beschrieben wird eine Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen von Elementen mit - einem WerKzeug (1), das einen Einlass (11) und einen Auglass (12) aufweist, - einer Zuführeinheit, die zu dem Einlass (11) eine Flüssigkeit fördert, in der abrasive Mittel

gelöst sind, und die aus dem Auslass (12 austritt, und - einer Positioniereinrichtung, die das Werkzeug über die zu bearbeitende Fläche führt und dabei derart positioniert, dass der Auslass der zu bearbeitenden Fläche gegenüber liegt, wobei die Fläche des durch die Begrenzungswände (13) des Auslasses (12) und die zu bearbeitende Fläche (2) gebildeten Ringspaltes (3) kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses (11) ist.

70 02/074489 A1

WO 02/074489 A1



TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

vor Ablauf der f\(\textit{u}\)r \(\textit{Anderungen der Anspr\(\text{u}\)checker
 Frist; \(\text{Ver\(\text{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen eintreffen}\)

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächenvon Elementen und insbesondere von Optischen Elementen bzw. Werkstücken

BESCHREIBUNG

Technisches Gebiet

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen von Elementen und insbesondere von optischen Elementen bzw. Werkstücken.

Stand der Technik

Zur abrasiven Bearbeitung von Flächen, wie sie beispielsweise für die Herstellung von optischen Elementen, wie Linsen, Prismen, planparallelen Platten etc., aber auch von Formen für das Gießen oder das Pressen optischer Elemente erforderlich ist, sind die verschiedensten Verfahren und Vorrichtungen bekannt. Bei vielen der bekannten Verfahren bzw. Vorrichtungen wird die zu bearbeitende Fläche mit kontaktierenden Werkzeugen, wie z.B. Teller-Schleifern, Kugelschleifern etc. zunächst einem Schleifvorgang sowie ggf. einem Feinschleifvorgang und anschließend mit einem Polierwerkzeug einem Poliervorgang unterzogen. An Stelle von Schleifvorgängen ist es auch bekannt, die Flächen auf einer Drehbank mit einem geeigneten Drehmeißel einem Drehvorgang zu unterziehen oder ein anderes spanabhebendes Verfahren anzuwenden. Die meisten Bearbeitungsvorgänge, bei denen vergleichsweise viel Material abgetragen wird, erfordern zumindest dann, wenn optische Flächen hergestellt

werden sollen, abschließend ein Polieren der Fläche.

Das Polieren erfolgt nach dem Stand der Technik bei
sphärischen Flächen großflächig mit einem Polierteller.

Probleme ergeben sich bei den herkömmlichen Verfahren 5 und Vorrichtungen immer dann, wenn asphärische Flächen hergestellt werden sollen. Die Herstellung asphärischer Flächen erfolgt nach dem Stand der Technik mit Werkzeugen wie Kugelschleifern, die einen mehr oder weniger punktförmigen Eingriff mit der zu bearbeitenden Fläche 10 haben und die längs einer Bahn über die zu bearbeitende Fläche geführt werden. Je nach Ausbildung des Werkzeugs wird die Fläche dabei geschliffen oder poliert. Aus Zeit- bzw. Kostengründen werden allerdings asphärische 15 Flächen häufig nur bahnförmig geschliffen; das Polieren erfolgt dann nicht bahnförmig, sondern großflächig. Insbesondere dann, wenn die Asphärizität vergleichsweise groß ist, wie dies beispielsweise bei progressiven Brillengläsern der Fall ist, ergibt sich durch das flä-20 chiqe Polieren ein mehr oder weniger großer Polierfehler, der durch entsprechende Fertigungsvorhalte bei den vorangehenden Bearbeitungsvorgängen kompensiert werden muss.

Weiterhin ist es bekannt, Flächen von Werkstücken und insbesondere von optischen Elementen mit Fluidstrahlen zu bearbeiten. Die hierfür vorgeschlagenen Vorrichtungen sind jedoch vergleichsweise aufwendig und erlauben auf Grund der mehr oder weniger punktförmigen Bearbeitung der Flächen.

10

Darstellung der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen und insbesondere zum Schleifen und/oder Polieren von Flächen von optischen Elementen anzugeben, die eine schnelle Bearbeitung der Flächen unabhängig von der Form der jeweils bearbeiteten Fläche erlaubt.

Eine erfindungsgemäße Lösung dieser Aufgabe ist im Patentanspruch 1 angegeben. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Ansprüche 2 bis 10. In den Ansprüchen 11 bis 14 sind mögliche Verwendungen der erfindungsgemäßen Vorrichtung beansprucht.

15 Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen und insbesondere zum Schleifen und/ oder Polieren von optischen Elementen ein Werkzeug auf, das einen Fluid-Einlass und einen Fluid-Auslass hat. Eine Zuführeinheit fördert zu dem Fluid-Einlass 20 eine Flüssigkeit, in der abrasive Mittel gelöst sind. Diese Flüssigkeit strömt durch das Werkzeug zu einem Auslass, durch den sie aus dem Werkzeug austritt. Erfindungsgemäß wird dieses Werkzeug durch eine Positioniereinrichtung derart relativ zu der zu bearbeitenden 25 Fläche positioniert, dass der Auslass, aus dem die Flüssigkeit austritt, der zu bearbeitenden Fläche insbesondere mit einem geringen Abstand gegenüber liegt. Dabei ist entscheidend, dass die Fläche des durch die Begrenzungswände des Auslasses und durch die zu bear-30 beitende Fläche gebildeten Ringspaltes kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses ist. Hierdurch tritt die Flüssigkeit, in der abrasive Mittel gelöst sind,

mit einem wesentlich höheren Druck als dem Druck, mit dem sie in den Einlass einströmt, durch den Ringspalt radial zum Werkzeug aus. Durch die radial ausströmende Flüssigkeit erfolgt die Bearbeitung der Fläche des

5 Werkstücks. Je nach der Art der in der Flüssigkeit gelösten abrasiven Mittel wird die Fläche im Bereich des Ringspaltes und damit linienförmig schleifend oder polierend bearbeitet. Durch die linienförmige Bearbeitung wird die Bearbeitungszeit im Vergleich zu den bekannten

10 Verfahren bzw. Vorrichtungen, bei denen ein im wesentlichen punktförmiger Eingriff zwischen Werkzeug und Werkstück besteht, um Größenordnungen verkürzt.

Das Verhältnis des Drucks, mit dem die Flüssigkeit in das Werkzeug einströmt, zu dem Druck, mit dem die Flüssigkeit aus dem Ringspalt austritt, ist dabei umgekehrt proportional zum Verhältnis der Querschnittsfläche des Einlasses zur Querschnittsfläche des gebildeten Ringspaltes. Dies bedeutet, dass der "Bearbeitungsdruck" durch die Positionierung des Werkzeugs relativ zum Werkstück – anders ausgedrückt durch die Einstellung der Höhe des Ringspaltes – eingestellt werden kann, ohne dass der Druck, mit dem die Zuführeinheit die Flüssigkeit fördert, geändert werden müsste.

25

30

15

20

Ein besonderer Vorteil der Erfindung ist dabei, dass einlassseitig mit vergleichsweise niedrigen Drücken gearbeitet werden kann: insbesondere kann die Zuführeinheit die Flüssigkeit mit einem Druck kleiner 20 bar, bevorzugt kleiner 5 bar, ggf. sogar nur mit Atmosphärendruck fördern. Für eine für den Bearbeitungsvorgang und die Bearbeitungsgeschwindigkeit vorteilhafte Druck-

erhöhung ist es bevorzugt, wenn die Querschnittsfläche des Einlasses wenigstens um den Faktor fünf größer als die Querschnittsfläche des gebildeten Ringspaltes ist. Dabei ist es weiterhin bevorzugt, wenn die Höhe des gebildeten Ringspaltes kleiner als 3 mm ist und insbesondere etwa 1 mm beträgt.

In jedem Falle ist es von Vorteil, wenn die Positioniereinrichtung eine Steuereinheit aufweist, die die Positionierung des Werkzeuges entsprechend den Flächendaten der herzustellenden Fläche steuert. Bevorzugt ist es, wenn die Positionierung des Werkzeugen dabei so erfolgt, dass die Höhe des Ringspaltes während der Verschiebung längs der jeweiligen Bahnen konstant bleibt.

15

20

25

30

10

5

Die Positioniereinrichtung kann das Werkzeug prinzipiell längs beliebiger Bahnen relativ zum Werkstück, d. h. zu der zu bearbeitenden Fläche verschieben. Beispielsweise kann die Bahn eine mäanderförmige Bahn sein, wobei entweder das Werkzeug oder das Werkstück oder beide bewegt werden.

Ferner kann eine gleichzeitige Verschiebung des Werkzeugs und des Elements, von dem eine Fläche bearbeitet werden soll, erfolgen. Im Falle rotationssymmetrischer Flächen oder nur geringfügig von der Rotationssymmetrie abweichender Flächen ist es bevorzugt, wenn das Werkzeug längs Bahnen bewegt wird, die durch den Flächenscheitel verlaufen und gleichzeitig das Werkstück bzw. das zu bearbeitende Element von einer Dreheinheit um eine Achse gedreht wird, die insbesondere die Rotationsachse der herzustellenden Fläche ist.

10

Um eine homogene Bearbeitung der Fläche längs des Ringspaltes zu erreichen, ist es ferner bevorzugt, wenn der Auslass einen kreisförmigen Querschnitt hat, und das Werkzeug zumindest im Bereich des Auslasses eine (kreis)-zylindrische Außenkontur aufweist.

Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung wird dadurch, dass die Querschnittsfläche des Einlasses kleiner als die des Auslasses ist, erreicht, dass eine Bearbeitung der Fläche nur linienförmig (bzw. kreisringförmig) im Bereich des Ringspaltes und nicht auch im Zentrum des Auslasses erfolgt.

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Größe des Werkzeugs der Form der zu bearbeitenden Fläche angepasst ist:

Zur Bearbeitung von planen Flächen kann der Außendurch20 messer des Werkzeugs im Bereich des Auslasses in der
Größenordnung der halben Apertur des optischen Elements
liegen, so dass eine sehr schnelle Bearbeitung der Fläche bei größtmöglicher Homogenität des Bearbeitungsvorganges erreicht wird. Bei der Bearbeitung von gekrümm25 ten Flächen liegt bevorzugt der Außendurchmesser des
Werkzeugs in der Größenordnung des kleinsten Radius
(kleinster Hauptkrümmungsradius) der Fläche; hierdurch
wird sichergestellt, dass die Höhe des Ringspaltes über
den gesamten gebildeten Ringspalt praktisch konstant
ist.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann zum Bearbeiten beliebiger Flächen von Elementen bzw. Werkstücken eingesetzt werden, die aus prinzipiell beliebigen Materialien bestehen können. Beispielsweise kann die erfindungsgemäße Vorrichtung aufgrund der hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit zur Bearbeitung von Turbinenschaufeln aus Stahl eingesetzt werden.

Besonders bevorzugt ist jedoch die Verwendung einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Schleifen und/oder Polieren optischer Flächen. Die jeweiligen Elemente können dabei im Falle von Linsen, Prismen, planparallelen
Platten etc. - d.h. direkt hergestellter optischer Elemente - aus Quarz, einem optischen Glas oder einem

Kunststoffmaterial bestehen; sollen Formen für das Gießen und/oder Pressen etc. von optischen Elementen hergestellt werden, können die Elemente auch aus einem Metall, wie Stahl, oder einem keramischen Material bestehen.

20

25

30

Da die Art des Abtrags im wesentlichen nicht von der Ausbildung des Werkzeugs, sondern von der Art der eingesetzten Flüssigkeit bzw. des (der) in der Flüssigkeit gelösten abrasiven Mittels (Mittel) abhängt, kann einund dieselbe Vorrichtung nacheinander zum Schleifen, gegebenenfalls Feinschleifen und abschließend zum Polieren eines Elements bzw. Werkstücks in ein- und derselben Aufspannung eingesetzt werden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Bearbeitungsarten bedingt dann lediglich einen Austausch bzw. Wechsel des jeweils verwendeten Bearbeitungsfluids.

In jedem Falle ist es jedoch besonders bevorzugt, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Bearbeitung von asphärischen Flächen eingesetzt wird.

5 Kurze Beschreibung der Zeichnung

Die Erfindung wird nachstehend ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnung exemplarisch beschrieben, auf die im übrigen hinsichtlich der Offenbarung aller im Text nicht näher erläuterten erfindungsgemäßen Einzelheiten ausdrücklich verwiesen wird. Es zeigen:

- Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung bei der Bearbeitung einer planen Fläche,
 - Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung bei der Bearbeitung einer gekrümmten und insbesondere asphärischen Fläche.

20

25

30

10

Darstellung eines Ausführungsbeispiels

Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung, von der lediglich das Werkzeug 1 dargestellt ist, bei der Bearbeitung einer planen Fläche 21 eines Werkstücks 2, das ohne Beschränkung der Allgemeinheit eine planparallele Platte ist. Das Werkzeug 1 weist einen Einlass 11 und einen Auslass 12 auf, dessen Querschnittsfläche größer ist als die des Einlasses 11. Eine nicht dargestellte Zuführeinheit fördert eine Flüssigkeit, in der abrasive Mittel, wie Schleifmittel oder Poliermittel gelöst sind, in den Einlass 11 des Werkzeugs 1. Das Werkzeug 1 wird von einer nicht dargestellten Positioniereinheit

20

derart relativ zum Werkstück 2 positioniert, dass zwischen den Begrenzungswänden 13 des Auslasses 12 und der Fläche 21 ein Ringspalt 3 gebildet wird, dessen Querschnittsfläche kleiner und bevorzugt wesentlich kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses 11 ist. Hierdurch wird der Druck, mit dem die Flüssigkeit aus dem Ringspalt 3 austritt, um das Verhältnis der Querschnittsflächen des Einlasses 11 und des Ringspaltes 3 erhöht. Der für die Bearbeitung der Werkstück-Oberfläche 21 wirksame Druck ist damit wesentlich größer als der Förderdruck.

Die nicht dargestellte Positioniereinrichtung verschiebt das Werkzeug 1 parallel zur Oberfläche des Werkstücks 2, während eine ebenfalls nicht dargestellte Dreheinheit das Werkstück 2 um eine Achse 22 dreht, so dass der linienförmige Eingriff längs des Ringspaltes 3 so über das Werkstück 2 verschoben wird, dass die gesamte Fläche 21 gleichmäßig bearbeitet, beispielsweise poliert wird.

Der Durchmesser des Werkzeugs 1 liegt in der Größenordnung des Radius des Werkstücks 2.

Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Vorrichtung bei der Bearbeitung einer gekrümmten und insbesondere asphärischen Fläche 21' eines Werkstücks 2. Gleiche Teile sind dabei mit den selben Bezugszeichen versehen, so dass auf eine erneute Vorstellung verzichtet wird. Der Durchmesser des Werkzeugs 1 liegt in der Größenordnung des kleinsten Radius der asphärischen Fläche 21'. Die ebenfalls nicht dargestellte Positioniereinheit ver-

schiebt das Werkzeug 1 längs Bahnen, die durch den Scheitel der Fläche 21' verlaufen. Gleichzeitig wird das Werkstück 2 um eine durch den Scheitel verlaufende Rotationsachse 22 gedreht.

5

Vorstehend ist die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen ohne Beschränkung des allgemeinen Erfindungsgedankens beschrieben worden.

30

PATENTANSPRÜCHE

- Vorrichtung zur abrasiven Bearbeitung von Flächen von Elementen mit
 - einem Werkzeug, das einen Einlass und einen Auslass aufweist,
- einer Zuführeinheit, die zu dem Einlass eine
 10 Flüssigkeit fördert, in der abrasive Mittel
 gelöst sind, und die aus dem Auslass austritt, und
 - einer Positioniereinrichtung, die das Werkzeug über die zu bearbeitende Fläche führt
- und dabei derart positioniert, dass der Auslass der zu bearbeitenden Fläche gegenüber liegt, wobei die Fläche des durch die Begrenzungswände des Auslasses und die zu bearbeitende Fläche gebildeten Ringspaltes kleiner als die Querschnittsfläche des Einlasses ist.
 - Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche des Einlasses wenigstens um den Faktor fünf größer als die Querschnittsfläche des gebildeten Ringspaltes ist.
 - 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des gebildeten Ringspaltes kleiner als 3 mm ist und bevorzugt etwa 1 mm beträgt.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch **gekennzeichnet**, dass eine Dreheinheit vorgesehen ist, die das zu bearbeitende Element um eine Achse dreht.

5

10

15

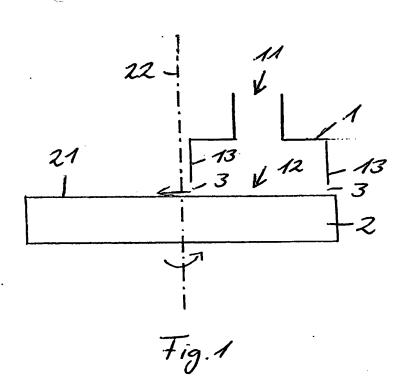
20

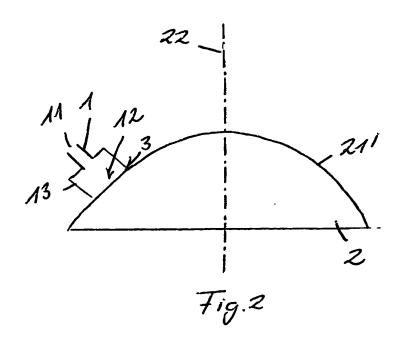
25

- 5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslass einen kreisförmigen Querschnitt hat, und dass das Werkzeug zumindest im Bereich des Auslasses eine zylindrische Außenkontur aufweist.
- 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Querschnittsfläche des Einlasses kleiner als die des Auslasses ist.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch **gekennzeichnet**, dass die Zuführeinheit die Flüssigkeit mit einem Druck kleiner 20 bar, bevorzugt kleiner 5 bar fördert.
 - 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch **gekennzeichnet**, dass zur Bearbeitung von planen Flächen der Außendurchmesser des Werkzeugs im Bereich des Auslasses in der Größenordnung der halben Apertur des optischen Elements liegt.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
 dadurch gekennzeichnet, dass bei der Bearbeitung
 von gekrümmten Flächen der Außendurchmesser des
 Werkzeugs in der Größenordnung des kleinsten Radius der Fläche liegt.

10

- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch **gekennzeichnet**, dass die Positionierein-richtung eine Steuereinheit aufweist, die die Positionierung des Werkzeuges entsprechend den Flächendaten der herzustellenden Fläche steuert.
- 11. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zum Schleifen optischer Flächen.
- 12. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zum Polieren optischer Flächen.
- 13. Verwendung einer einzigen Vorrichtung nach einem
 der Ansprüche 1 bis 10 zunächst zum Schleifen und anschließend zum Polieren einer optischen Fläche.
- 14. Verwendung einer Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Bearbeitung von asphärischen20 Flächen.









PC1/LP 02/03120 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B24B31/116 B24B13/00 B24C1/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 B24B B24C Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category * Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X US 5 700 181 A (ARMSTRONG NEIL DEAN 1,3,5,6, AL) 23 December 1997 (1997-12-23) 11-13 column 1, line 9 - line 14 Y abstract 4,7,10 column 3, line 32 -column 4, line 10 column 4, line 51 - line 60 A 14 figures 1,2,4,5 WO 99 26764 A (TNO ; FAHNLE OLIVER WOLFGANG Y 4,7 (NL)) 3 June 1999 (1999-06-03) page 1, line 1 -page 3, line 14 page 5, line 16 - line 26 Α 1,5,10, figure 1 -/--Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&* document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the International search report 17 July 2002 26/07/2002

Name and mailing address of the ISA

Fax: (+31-70) 340-3016

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, **Authorized officer**

Schultz, T





		PC1/EP 02/03120		
C.(Continua	INTO DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages		Relevant to claim No.	
Υ	US 5 573 446 A (DEY THOMAS W ET AL) 12 November 1996 (1996-11-12) column 2, line 65 -column 4, line 37 figure 1		10	

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)



Internal Application No PC 1/ E? 02/03120

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US 5700181	Α	23-12-1997	NONE		
WO 9926764	Α	03-06-1999	NL	1007589 C1	25-05-1999
			AU	1264199 A	15-06-1999
			ΕP	1032486 A2	06-09-2000
			JP	2001523589 T	27-11-2001
			WO	9926764 A2	03-06-1999
US 5573446	Α	12-11-1996	NONE		